

<<电子产品制造技术>>

图书基本信息

书名：<<电子产品制造技术>>

13位ISBN编号：9787115154965

10位ISBN编号：7115154961

出版时间：2007-3

出版时间：人民邮电

作者：陈振源

页数：200

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电子产品制造技术>>

内容概要

《电子产品制造技术》是依据行业职业技能鉴定规范，并参考现代电子企业的生产技术文件而编写的。

主要内容包括电子产品生产流程及技术文件、电子整机装配常用器材、印制电路板制作、电子元器件的插装与焊接、表面元件安装技术、整机装配和调试、整机检验与包装以及与理论知识相配套的实践训练项目。

本书是按电子产品的生产流程来构建课程的结构体系，在实践性、实用性和针对性方面凸显了编写特色。

《电子产品制造技术》表述简约清楚，通俗易懂，重点突出，教学内容贴近生产实际，贴近电子企业的岗位需求，适合中等职业教育电子专业学生使用，亦可作为电子企业技术工人的培训用书。

<<电子产品制造技术>>

书籍目录

第1章 电子产品生产流程及技术文件1.1 电子产品的生产工艺流程1.1.1 装配工艺的一般流程1.1.2 流水线的工作方式1.2 技术文件1.2.1 技术文件的特点1.2.2 设计文件1.2.3 工艺文件1.3 识图方法1.3.1 怎样识读方框图1.3.2 怎样识读电路原理图1.3.3 怎样看印制电路板图1.3.4 怎样看装配图1.4 实践项目1.4.1 电子产品的技术文件绘制*1.4.2 彩电主板的识读训练本章小结思考与练习第2章 电子整机装配常用器材2.1 阻容感元件2.1.1 电阻器2.1.2 电容器2.1.3 电感器2.2 半导体器件2.2.1 二极管2.2.2 晶体三极管2.2.3 集成电路2.3 机电元件2.3.1 接插件2.3.2 开关2.3.3 继电器2.4 电子元器件的检验和筛选2.4.1 外观质量检验2.4.2 电气性能使用筛选2.5 常用材料2.5.1 导线2.5.2 常用绝缘材料2.6 常用装配工具2.6.1 钳子2.6.2 镊子2.6.3 螺丝刀2.6.4 热溶胶枪2.6.5 风剪2.7 实践项目2.7.1 电阻器的识读和测量2.7.2 电容器的识读和测量2.7.3 二极管和三极管的检测本章小结思考与练习*第3章 印制电路板制作3.1 概述3.1.1 印制电路板的作用3.1.2 印制电路板的种类3.1.3 印制电路板设计步骤3.1.4 印制电路板设计要求3.2 印制电路板的制造3.2.1 印制电路板的制造工艺流程3.2.2 印制电路板的手工制作3.3 印制电路板CAD软件简介3.3.1 软件概述3.3.2 电路原理图绘制3.3.3 绘制印制电路板3.4 实践项目3.4.1 印制电路板图的绘制3.4.2 用热转印法制作印制电路板本章小结思考与练习第4章 电子元器件的插装与焊接4.1 印制电路板组装的工艺流程4.1.1 印制电路板组装工艺流程介绍4.1.2 印制电路板装配工艺的要求4.2 电子装配的静电防护4.2.1 静电产生的因素4.2.2 静电的危害4.2.3 电子装配的静电防护4.3 电子元器件的插装4.3.1 元器件的分类与筛选4.3.2 元器件引脚成形4.3.3 插件技术4.4 手工焊接工艺4.4.1 焊料与焊剂4.4.2 焊接工具的选用4.4.3 手工焊接的工艺流程和方法4.4.4 导线和接线端子的焊接4.4.5 印制电路板上的焊接4.5 电子工业生产中的焊接方法4.5.1 浸焊4.5.2 波峰焊接技术4.5.3 双波峰焊接工艺4.5.4 二次焊接工艺简介4.6 焊接质量的分析及焊4.6.1 焊接质量分析4.6.2 拆焊4.7 实践项目4.7.1 印制电路板上元器件的焊接4.7.2 集成电路在印制电路板上的焊接4.7.3 印制电路板上元器件的拆焊本章小结思考与练习第5章 表面元器件安装技术5.1 表面安装技术概述5.1.1 表面安装技术的发展5.1.2 表面安装技术的特点5.1.3 表面安装技术的工艺流程5.2 表面安装元器件5.2.1 表面安装无源元器件5.2.2 表面安装有源元器件5.3 表面安装材料与设备5.3.1 表面安装材料5.3.2 表面安装设备5.4 表面安装电路板的检修5.4.1 表面安装电路板的质量检查5.4.2 表面安装电路板的修理*5.5 微组装技术5.5.1 球栅阵列封装5.5.2 芯片规模封装5.5.3 芯片直接贴装技术5.6 实践项目5.6.1 参观回流焊及表面安装技术实际操作5.6.2 表面安装元器件的焊接和拆焊训练本章小结思考与练习第6章 整机总装和调试6.1 整机总装前的准备工6.1.1 装接线的端头处理6.1.2 电缆的加工6.1.3 线扎成形加工6.2 整机总装工艺6.2.1 整机总装的工艺流程和原则6.2.2 总装操作对整机性能的影响6.2.3 典型产品总装示例6.3 整机调试6.3.1 整机调试的内容和分类6.3.2 整机调试的一般程序和方法6.3.3 常用的测试仪器6.3.4 典型产品调试示例6.4 电子产品的故障检测和排除6.4.1 电子产品出现故障的原因6.4.2 检测和排除故障的方法6.5 实践项目6.5.1 导线与电缆线的端头加工6.5.2 线把扎制6.5.3 组装直流稳压电源6.5.4 收录机的拆卸和装配本章小结思考与练习第7章 整机检验与包装7.1 整机检验7.1.1 整机检验的方法7.1.2 整机检验的主要内容7.1.3 电子整机检验举例7.1.4 机壳外观故障的检查与修复7.2 电子整机产品的老化和环境试验7.2.1 整机产品的老化7.2.2 整机产品的环境试验*7.3 电子产品包装7.3.1 电子产品包装的种类与基本原则7.3.2 包装材料和要求7.3.3 电子整机包装工艺*7.4 电子产品质量管理及ISO 9000标准系列7.4.1 GB/T 19000与ISO 9000标准系列7.4.2 实施GB/T 19000标准系列的意义7.4.3 中国强制认证7.5 实践项目7.5.1 电子产品塑料外壳刮伤的修整7.5.2 参观电子企业的产品包装线本章小结思考与练习参考文献

<<电子产品制造技术>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>